

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零一五年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2015年11月10日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一五年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一五年第三季度主要財務指標

- 銷售額 1.724 億美元，與上季度持平，同比下降 0.9%。
- 毛利率 30.6%，較上季度的 33.0% 及去年同期的 32.2% 有所下降。
- 淨利潤 3,020 萬美元，環比減少 17.2%，同比增長 3.8%。

二零一五年第四季度指引

- 第四季度主營業務收入預計比去年同期減少（三個工廠中的兩個主要工廠年度大修停產 4 天）。
- 預計全年主營業務收入比去年減少 1,000 萬美元~2,000 萬美元。
- 全年營業利潤預計不低於去年水平。

“儘管全球半導體行業普遍疲軟，華虹半導體在二零一五年第三季度的業績仍然穩固”，華虹半導體總裁兼執行董事王煜先生表示。

“值得關注的是，自上一季度業績披露以來，集成電路行業增速顯著放緩。與大多數集成電路製造企業一樣，我們將在未來 3~6 個月內面臨嚴峻挑戰。我們預計這將在中國和全球範圍內對我們所關注的所有領域產生廣泛影響。即便如此，我想強調的是，憑借穩健的財務狀況和堅實的經營計劃，我們將從容地應對這一風暴。最重要的是，我們預期將會繼續保持盈利。”

電話會議公告

日期：二零一五年十一月十一日

時間：香港時間上午十時

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php or
<https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2015q3earningscall>

電話	國際	+61 283 733 610
詳細：	中國	+86 800 870 0210 +86 400 120 3170
	香港	+852 3051 2792
	臺灣	+886 2 7743 8419
	美國	+1 845 507 1610
	新加坡	+65 3158 0667

電話會議登入名： 71637445

密碼： HUAHONG

該電話會議廣播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都將在本新聞稿廣播後 6 個月內刊登於華虹半導體的網站上。

關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製造成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>

二零一五年第三季度經營業績概要
(以千美元為單位，每股盈利和營運數據除外)

	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第三季度 (未經審核)	同比
銷售收入	172,357	172,284	-	174,002	(0.9)%
銷售成本	(119,681)	(115,370)	3.7 %	(117,966)	1.5 %
毛利	52,676	56,914	(7.4)%	56,036	(6.0)%
毛利率	30.6 %	33.0%	(2.4)%	32.2 %	(1.6)%
經營開支	(28,032)	(30,354)	(7.6)%	(23,308)	20.3 %
其他收入，淨額	9,602	6,318	52.0 %	4,861	97.5 %
稅前溢利	34,246	32,878	4.2 %	37,589	(8.9)%
所得稅開支	(4,015)	3,645	(210.2)%	(8,476)	(52.6)%
期內溢利	30,231	36,523	(17.2)%	29,113	3.8 %
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	30,231	36,523	(17.2)%	29,113	3.8 %
非控制權益	-	-	-	-	-
持有人應佔每股盈利					
基本	0.03	0.04	(25.0)%	0.04	(25.0)%
攤薄	0.03	0.04	(25.0)%	0.04	(25.0)%
付運晶圓(仟片)	384	375	2.4 %	372	3.2 %
產能利用率 ¹	90.4 %	94.4%	(4.0)%	96.1 %	(5.7)%

- 銷售額 1.724 億美元，與上季度持平，同比下降 0.9%。
- 銷售成本 1.197 億美元，環比增加 3.7%，同比增加 1.5%，主要由於擴產而使折舊費用上升所致。
- 毛利率 30.6%，較上季度的 33.0% 下降了 2.4 個百分點，主要由於折舊費用上升所致。
- 經營開支 2,800 萬美元，比上季度的 3,040 萬美元下降了 7.6%，主要由於上季度計提 510 萬美元的設備減值，同時被第三季度研發費用增加 210 萬美元所抵消。
- 其他收入，淨額 960 萬美元，環比增加 52.0%，主要由於匯兌收益的增加，同時被分佔一家聯營公司虧損所抵消。
- 所得稅開支 400 萬美元，與上季度的差異主要是由於第二季度沖回前期計提的股利分配代扣代繳稅金 1,160 萬美元所致。
- 期內溢利 3,020 萬美元，環比減少 17.2%。

¹ 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

銷售收入分析

按類別劃分的銷售收入	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)
晶圓	96.9%	97.5%	96.4%
其他	3.1%	2.5%	3.6%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 本季度 96.9% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的銷售收入	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)
中國 ²	54.1%	56.1%	52.7%
美國	19.1%	19.0%	23.0%
歐洲	10.1%	8.4%	9.3%
日本 ³	9.0%	8.4%	5.1%
亞洲 ⁴	7.7%	8.1%	9.9%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 中國區域仍是我們最大的市場，本季度其貢獻的銷售額占總銷售額的 54.1%，較上季度下降 2.0 個百分點，主要由於一些客戶對 SIM 卡類芯片的需求減少所致。
- 本季度歐洲區域的銷售額占總銷售額的 10.1%，比上季度上升 1.7 個百分點，得益於一些客戶對 SIM 卡類芯片的需求上升。
- 本季度日本地區的銷售額占總銷售額的比重進一步上升至 9.0%，得益於客戶對微控制器產品的需求上升。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的銷售收入	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)
嵌入式非易失性存儲器	44.1%	42.7%	45.9%
分立器	22.8%	20.2%	18.7%
模擬與電源管理	15.7%	18.6%	17.5%
邏輯及射頻	12.4%	13.0%	11.5%
獨立非易失性存儲器	4.8%	4.9%	5.6%
其他	0.2%	0.6%	0.8%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 本季度來自嵌入式非易失性存儲器產品的銷售額占總銷售額的 44.1%，較上季度上升 1.4 個百分點，得益於來自日本地區微控制器產品和歐洲地區 SIM 卡類芯片的需求上升，部分被來自中國地區的 SIM 卡類芯片的需求下降所抵消。
- 本季度分立器產品銷售額占總銷售額的 22.8%，較上季度上升 2.6 個百分點，得益於 MOSFET、超級結及 IGBT 等各類產品的需求上升。
- 受 LED 照明產品和音頻相關產品的需求下降的影響，模擬與電源管理類產品銷售額占總銷售額的比例由上季度的 18.6% 下降至本季度的 15.7%。

² 包括香港。

³ 包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。

⁴ 不包括中國及日本。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)
0.13 μm 及以下	36.9%	38.4%	39.4%
0.15 μm 及 0.18 μm	17.2%	18.2%	18.7%
0.25 μm	3.8%	2.0%	1.0%
0.35 μm 及以上	42.1%	41.4%	40.9%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 本季度來自 0.13μm 及以下工藝技術節點產品銷售額占總銷售額的 36.9%，環比下降 1.5 個百分點，主要由於一些中國客戶對 SIM 卡類芯片的需求下降所致。
- 本季度來自 0.25μm 工藝技術節點產品銷售額占總銷售額的 3.8%，環比增加 1.8 個百分點，主要由於一些日本客戶對於微控制器產品的需求增加所致。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)
電子消費品	58.3%	57.7%	48.7%
通訊	21.3%	22.5%	29.8%
工業及汽車	13.7%	12.6%	10.3%
計算機	6.7%	7.2%	11.2%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 電子消費品及通訊仍分別為我們第一及第二大終端市場分佈，本季度這兩類市場合計貢獻 79.6% 的銷售額。
- 電子消費品銷售額占總銷售額的 58.3%，環比上升 0.6 個百分點，主要得益於客戶對微控制器產品的強勁需求。本季度通訊產品銷售額占總銷售額的 21.3%，環比下降 1.2 個百分點，主要由於客戶對 SIM 卡類芯片需求的減少所致。

產能⁵及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	52	50	50
2 號晶圓廠	45	42	39
3 號晶圓廠	40	40	40
總估計月產能	137	132	129
產能利用率	90.4%	94.4%	96.1%

- 由於產能增加和產量減少，產能利用率由上季度的 94.4% 下降至本季度的 90.4%。

⁵ 期末每月可製造晶圓片數，且為了可比，以 30 天計。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第三季度 (未經審核)	同比
付運晶圓	384	375	2.4%	372	3.2%

- 付運晶圓達到 384 仟片，較上季度的 375 仟片上升 2.4%。

經營開支分析

以千美元計	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第三季度 (未經審核)	同比
銷售及分銷費用	1,688	1,586	6.4%	1,558	8.3%
管理費用 ⁶	26,344	28,768	(8.4)%	21,750	21.1%
經營開支	28,032	30,354	(7.6)%	23,308	20.3%

- 本季度經營開支 2,800 萬美元，環比下降 7.6%，主要由於上季度計提 510 萬美元的設備減值，同時被第三季度研發費用因工程片增加 210 萬美元所抵消。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第三季度 (未經審核)	同比
租金收入	3,264	3,432	(4.9)%	3,251	0.4%
利息收入	2,329	2,195	6.1%	1,299	79.3%
匯兌收益	4,470	627	612.9%	-	-
分佔一家聯營公司溢利(損失)	(668)	1,083	(161.7)%	1,591	(142.0)%
財務費用	(1,894)	(1,981)	(4.4)%	(2,958)	(36.0)%
其他	2,101	962	118.4%	1,678	(252.2)%
其他收入淨額	9,602	6,318	52.0%	4,861	97.5%

- 本季度其他收入淨額 960 萬美元，環比增加 52.0%，主要由於人民幣貶值致匯兌收益增加，同時被分佔一家聯營公司虧損所抵消。

⁶管理費用包括確認為研發開支抵消項目的政府補助。

現金流量概要

以千美元計	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第三季度 (未經審核)	同比
經營活動所得(用)現金流量淨額	85,716	(6,639)	1,391.1 %	64,944	32.0%
投資活動所得(用)現金流量淨額	22,342	(197,582)	111.3 %	(18,884)	(218.3)%
融資活動所用現金流量淨額	(1,861)	(21,636)	(91.4)%	(2,903)	(35.9)%
外匯匯率變動影響淨額	(7,162)	1,417	(605.4)%	1,106	(747.6)%
現金及現金等價物增加(減少)淨額	99,035	(224,440)	(144.1)%	44,263	123.7 %

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 8,570 萬美元，環比增加 1391.1%，得益于應收款回收及時以及本季度收回上季度用於質押開立信用證的存款 4,140 萬美元。
- 本季度投資活動所得現金流量淨額 2,230 萬美元，其中包括銀行理財產品到期收回 2,890 萬美元，定期存款到期收回 3,280 萬美元，收到利息收入 280 萬美元，部分被設備投資支出 4,220 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 190 萬美元，系向銀行償還的銀行貸款利息。

流動性概述

以千美元計	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)
存貨	84,093	85,061
貿易應收款項及應收票據	121,962	118,615
預付款項、按金及其他應收款項	13,779	36,808
應收關聯方款項	33,450	37,541
其他金融資產	122,304	156,700
已抵押存款及定期存款	23,332	94,445
現金及現金等價物	433,972	334,937
流動資產總額	832,892	864,107
貿易應付款項	57,161	58,169
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	70,531	81,413
計息銀行借款	61,343	62,096
政府補助	57,980	60,274
應付關聯方款項	12,514	17,361
應付所得稅	20,253	17,451
流動負債總額	279,782	296,764
淨營運資金	553,110	567,343
速動比率	2.7x	2.6x
流動比率	3.0x	2.9x

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 3,680 萬美元減少至 1,380 萬美元，主要由於本季度對供應商預付款減少所致。
- 應收關聯方款項由上季度末的 3,750 萬美元減少至 3,350 萬美元，主要由於收回對關聯方的銷售應收款及對一些關聯方客戶的銷售額下降所致。
- 其他金融資產由上季度末的 1.567 億美元減少至 1.223 億美元，系銀行理財產品減少所致。
- 已抵押存款及定期存款由上季度末的 9,440 萬美元減少至 2,330 萬美元，主要由於定期存款和被質押的存款減少所致。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 8,140 萬美元減少至 7,050 萬美元，主要由於 i) 支付第一、第二季度計提的員工獎金；以及 ii) 購買固定資產應付款減少所致。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,740 萬美元減少至 1,250 萬美元，主要由於確認了二零一五年第三季度的關聯方房屋租金所致。
- 應付所得稅由上季度末的 1,750 萬美元增加至 2,030 萬美元，主要由於本季度計提了 470 萬美元當期所得稅，同時支付了 120 萬美元稅金所致。
- 淨營運資金為 5.531 億美元，流動比率為 3.0；上季度末淨營運資金為 5.673 億美金，流動比率為 2.9。

資本結構

以千美元計	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)
現金及現金等價物	433,972	334,937
已抵押存款及定期存款	23,332	94,445
其他金融資產	122,304	156,700
短期計息銀行借款	61,343	62,096
長期計息銀行借款	181,455	183,068
銀行借款總額	242,798	245,164
權益	1,499,476	1,528,960
資本負債比率 ⁷	(22.5)%	(22.3)%

資本開支概要

- 資本開支為 4,220 萬美元，上季度為 7,260 萬美元。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com

⁷ (銀行借款 - 現金及現金等價物 - 已抵押存款及定期存款 - 其他金融資產) / 總權益

華虹半導體有限公司
簡明綜合損益表
(以千美元計, 除每股盈利和股數外)

	截至以下日期止三個月	
	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)
銷售收入	172,357	172,284
銷售成本	(119,681)	(115,370)
毛利	52,676	56,914
其他收入及收益	12,164	7,216
銷售及分銷費用	(1,688)	(1,586)
管理費用	(26,344)	(28,768)
財務費用	(1,894)	(1,981)
分佔一家聯營公司溢利	(668)	1,083
稅前溢利	34,246	32,878
所得稅開支	(4,015)	3,645
期內溢利	30,231	36,523
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	30,231	36,523
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.03	0.04
攤薄	0.03	0.04
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,034,549,815	1,033,871,656

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至	
	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	633,940	626,432
投資物業	184,237	191,702
預付土地租賃款項	22,753	23,855
無形資產	11,710	13,390
於聯營公司的投資	42,352	44,765
可供出售投資	221,731	230,715
長期預付款項	8,719	11,930
遞延稅項資產	6,598	7,179
非流動資產總額	1,132,040	1,149,968
流動資產		
存貨	84,093	85,061
貿易應收款項及應收票據	121,962	118,615
預付款項、按金及其他應收款項	13,779	36,808
應收關聯方款項	33,450	37,541
其他金融資產	122,304	156,700
已抵押存款及定期存款	23,332	94,445
現金及現金等價物	433,972	334,937
流動資產總額	832,892	864,107
流動負債		
貿易應付款項	57,161	58,169
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	70,531	81,413
計息銀行及其他借款	61,343	62,096
政府補助	57,980	60,274
應付關聯方款項	12,514	17,361
應付所得稅	20,253	17,451
流動負債總額	279,782	296,764
流動資產淨額	553,110	567,343
總資產減流動負債	1,685,150	1,717,311
非流動負債		
計息銀行及其他借款	181,455	183,068
遞延稅項負債	4,219	5,283
非流動負債總額	185,674	188,351
淨資產	1,499,476	1,528,960
權益和負債權益		
股本	1,550,164	1,550,164
儲備	(50,688)	(21,204)
權益總額	1,499,476	1,528,960

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月	
	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)
經營活動所得(用)現金流量		
稅前溢利	34,246	32,878
折舊及攤銷	22,038	17,919
應佔聯營公司溢利	668	(1,083)
營運資金的變動及其它	28,764	(56,353)
經營活動所得(用)得現金流量淨額	85,716	(6,639)
投資活動所得(用)現金流量:		
購買物業、廠房及設備項目	(42,176)	(72,551)
其他投資活動所用的現金流量	64,518	(125,031)
投資活動所得(用)現金流量淨額	22,342	(197,582)
融資活動所用現金流量:		
償還銀行貸款	-	(19,628)
已付利息	(1,861)	(2,008)
融資活動所用現金流量淨額	(1,861)	(21,636)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	106,197	(225,857)
外匯匯率變動影響淨額	(7,162)	1,417
期初現金及現金等價物	334,937	559,377
期末現金及現金等價物	433,972	334,937

於本公告日期，本公司董事分別為:

執行董事

傅文彪(董事長)
王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波
馬玉川
森田隆之
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍蜚

承董事會命
華虹半導體有限公司
傅文彪
董事長兼執行董事

中國 香港
二零一五年十一月十日